



首页 学院概况 学院动态 本科教育 研究生培养 科学研究 实验室建设 学生与党建
校友之窗 就业实习信息

赵春洋 助理教授-特聘副研究员

研究领域:

- 1) 激光制造（面向硬脆难加
- 2) 激光制造过程的在线监测
- 3) 仿真分析（激光制造过程
- 4) 机器视觉及信号处理（激

主讲本科课程:

工程制图

主讲研究生课程:

智能制造技术

教育背景:

2005-2009年 哈尔滨工程大学，学士；
2010-2017年 哈尔滨工业大学，硕士，博士。

工作经历:

性别：男

邮箱：zcy724317@163.com

办公室：机电楼S801

人才称号：

最终学位：博士

办公电话：13718715734

导师资格：硕士生导师

2020年至今 深圳大学，助理教授，特聘副研究员；
2018-2020年 哈尔滨工业大学，博士后；
2017-2020年 科技部高技术研究发展中心，专项主管。

主持项目：

- 1) 国家自然科学基金（青年项目），24万元，在研，主持
 - 2) 国家自然科学基金（航天联合基金），32万元，在研，主持参与
 - 3) 国家重点研发计划（科技助力）2项，160万元，在研，主持参与
 - 4) 国家重点实验室开放课题，4万元，在研，主持
 - 5) 深圳市稳定支持A类，20万元，在研，主持
-

代表期刊论文：

- 1) Chunyang Zhao, et al. Dual laser beam revising the separation path technology of LITP ... [J]. International J. of Machine Tools & Manufacture, 106 (2016) 43-55. [中科院1区, IF=6.039, TOP期刊]
 - 2) Chunyang Zhao, et al. Investigation on the crack propagation behavior and edge quality ... [J]. Journal of materials processing technology, 275(2020). [中科院2区, IF=4.178, TOP期刊]
 - 3) Chunyang Zhao, et al. Semiconductor laser asymmetry cutting glass with LITP... [J]. Optics and Lasers in Engineering, 63 (2014) 43 - 52. [中科院2区, IF=4.059]
 - 4) Chunyang Zhao, et al. Effect of focus position and shear stresses on the crack sectional shape ... [J]. Proc IMechE Part B: J Engineering Manufacture, 231(2017)2094-2102. [中科院4区, IF=1.752]
 - 5) Chunyang Zhao, et al Three-Dimensional Numerical Simulation of Meso-Scale-Void Formation ... [J]. APPLIED COMPOSITE MATERIALS, 26(2019) 1121-1137. [中科院4区, IF=1.556]
-

代表会议论文：

- 1) C.Y. Zhao, et al. Research on laser induced thermal-crack propagation cutting silicon wafer [C]. 2012 International Conference on Manufacturing Engineering and Technology for Manufacturing Growth (METMG 2012). San Diego, USA.
- 2) Chunyang Zhao, et al. Curve Cutting ZrO₂ Ceramic and Cooling Lower Surface Cutting Silicon Wafer With Laser Induced Thermal-Crack Propagation [C]. 2014 the 3rd International Conference on Mechanical Engineering, Materials Science and Civil Engineering (ICMEMSCE2014). Phuket Island, Thailand.

3) 赵春洋, 杨立军, 王扬. 激光诱导热裂切割陶瓷工艺技术研究. 航天制造技术发展论坛. 北京. 2012. 10. 17.

4) 赵春洋, 杨立军, 王扬. 激光诱导热裂切割硅片技术研究. 绿色制造技术论坛. 北京. 2012. 12. 03.

代表专利:

三明治基板结构双束激光加工方法及装备, 专利号: ZL201410047593.7, 发明人: 张宏志; 杨立军; 王扬; 赵春洋; 刘俊岩; 王懋露。

上一篇: 没有了

下一篇: 没有了